

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成17年3月17日(2005.3.17)

【公表番号】特表2004-508679(P2004-508679A)

【公表日】平成16年3月18日(2004.3.18)

【年通号数】公開・登録公報2004-011

【出願番号】特願2002-525882(P2002-525882)

【国際特許分類第7版】

H 0 5 B 33/04

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14

【F I】

H 0 5 B 33/04

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14

A

【手続補正書】

【提出日】平成15年4月23日(2003.4.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

セル領域を有する基板、
セル領域を包囲するシーリング囲い枠、
シーリング囲い枠によって支持されたキャップ、
シーリング囲い枠の外側表面に当接するシーリング領域及び
シーリング領域内に配置された接着剤
からなり、前記接着剤はデバイスを気密にシールし、その際シーリング囲い枠はデバイスのシーリング幅を減少させることを特徴とするデバイス。

【請求項2】

セル領域がO L E Dセルからなる、請求項1記載のデバイス。

【請求項3】

基板が透明な基板からなる、請求項1又は2記載のデバイス。

【請求項4】

基板がフレキシブルな基板からなる、請求項1から3までのいずれか1項記載のデバイス。

【請求項5】

シーリング囲い枠が非導電性材料からなる、請求項1から4までのいずれか1項記載のデバイス。

【請求項6】

接着剤が熱硬化した接着剤からなる請求項1から5までのいずれか1項記載のデバイス。

【請求項7】

シーリング囲い枠が感光性材料からなる、請求項1から6までのいずれか1項記載のデバイス。

【請求項8】

シーリング囲い枠が多重層からなる、請求項1から7までのいずれか1項記載のデバイス

。

【請求項 9】

基板と接触したシーリング囲い枠の少なくとも 1 つの底部層が非導電性材料からなる、請求項 8 記載のデバイス。

【請求項 10】

デバイスを形成する方法において、

セル領域を含む基板を準備し、

シーリング囲い枠を有するキャップを準備し、

キャップを基板上に取り付け、その際シーリング囲い枠はセル領域を包囲しかつシーリング囲い枠の外側表面に当接するシーリング領域を形成し、

基板に対するシーリング囲い枠の接触を確保するために圧力を及ぼし、かつ

シーリング領域に接着剤を施し、該接着剤は基板を気密にシールし、その際該シーリング囲い枠はデバイスのシーリング幅を減少させるために基板とキャップの間のギャップを排除することからなるカプセル化を含むことを特徴とする、デバイスを形成する方法。

【請求項 11】

基板を準備することが、基板のセル領域内に O L E D セルを形成することを含む、請求項 10 記載の方法。

【請求項 12】

基板がフレキシブルな基板からなる、請求項 10 又は 11 記載の方法。

【請求項 13】

基板が透明な基板からなる、請求項 10 から 12 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 14】

囲い枠を有するキャップを準備することが、キャップ基板上にシーリング囲い枠を形成することよりなる、請求項 10 から 13 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 15】

シーリング囲い枠の形成が、

キャップ基板上にデバイス層を付着させかつ

デバイス層をパターン化して、キャップ基板上にシーリング囲い枠を形成することよりなる、請求項 14 記載の方法。

【請求項 16】

デバイス層が感光性層からなる、請求項 15 記載の方法。

【請求項 17】

更に、接着剤を硬化させることよりなる、請求項 10 から 16 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 18】

シーリング囲い枠が感光性材料からなる、請求項 10 から 17 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 19】

デバイスを形成する方法において、

セル領域を含む基板を準備し、

基板上にシーリング囲い枠を形成し、その際シーリング囲い枠はセル領域を包囲し、

キャップを基板上に取り付け、その際シーリング領域はシーリング囲い枠の外側表面に当接し、

基板に対するシーリング囲い枠の接触を確保するために圧力を及ぼし、かつ

シーリング領域に接着剤を施し、該接着剤は基板を気密にシールし、その際該シーリング囲い枠はデバイスのシーリング幅を減少させるためにキャップと基板の間のギャップを排除することからなるカプセル化を含むことを特徴とする、デバイスを形成する方法。

【請求項 20】

基板を準備することが、基板のセル領域内に O L E D セルを形成することを含む、請求項 19 記載の方法。

【請求項 21】

基板がフレキシブルな基板からなる、請求項 19 又は 20 記載の方法。

【請求項 22】

基板が透明な基板からなる、請求項 19 から 21 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 23】

シーリング囲い枠の形成が、

基板上にデバイス層を付着させかつ

デバイス層をパターン化して、基板上にシーリング囲い枠を形成することよりなる、請求項 19 から 22 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 24】

デバイス層が感光性層からなる、請求項 19 から 23 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 25】

シーリング囲い枠が感光性材料からなる、請求項 19 から 24 までのいずれか 1 項記載の方法。

【請求項 26】

更に、接着剤を硬化させることよりなる、請求項 19 から 25 までのいずれか 1 項記載の方法。